

**NEW**

모듈러 보링 시스템 (소경·중경용)

## 보링 툴 / SBHJ (소경사상가공용)

MODULAR BORING TOOL

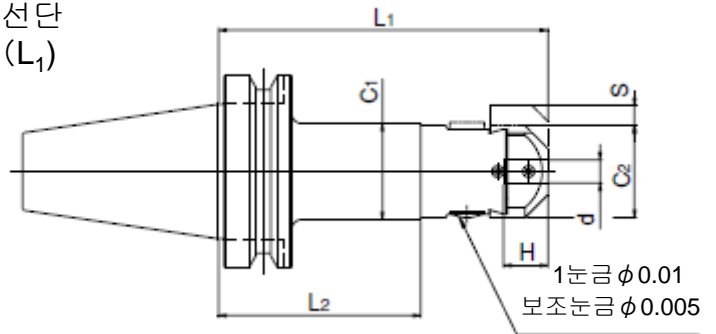
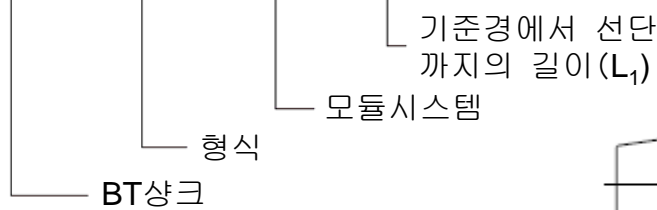


- 종래 일체형이던 보링툴을 홀더부와 상크부로 분리 표준 모듈화

### BT 상크

#### 표시방법

BT50 - SBHJ03MSC - 171



품번 296	셋트형식번호	가공범위 D*	L1 (mm)	L2 (mm)	C1 (mm)	C2 (mm)	d (mm)	H (mm)	S (mm)	질량 (kg)
992424	BT40-SBHJ03MSC-171	3~36	171	105	50	48	12	23	10	3.2
992425	BT50-SBHJ03MSC-171		171	105						5.8
992426	BT50-SBHJ03MSC-231		231	165						6.8

- L형 육각 스패너가 부착되어 있습니다.
- 바이트 및 칩은 부착되어있지 않습니다. 별도 구입 바랍니다.
- D\*는 톱보러바이트 사용시  $\phi 5.5 \sim \phi 32$  지그보러바이트 (+클램핑슬리브) 사용시  $\phi 3 \sim \phi 36$  입니다.

### 조합

품번 296	셋트형식번호	품번 296	상크형식번호	품번 296	헤드형식번호
992424	BT40-SBHJ03MSC-171	992225	BT40-MSC50-105	992092	MSC50-SBHJ03
992425	BT50-SBHJ03MSC-171	992232	BT50-MSC50-105		
992426	BT50-SBHJ03MSC-231	992233	BT50-MSC50-165		

**NEW**

모듈러 보링 시스템 (소경·중경용)

## 보링 툴 / SBHJ (소경사상가공용)

MODULAR BORING TOOL

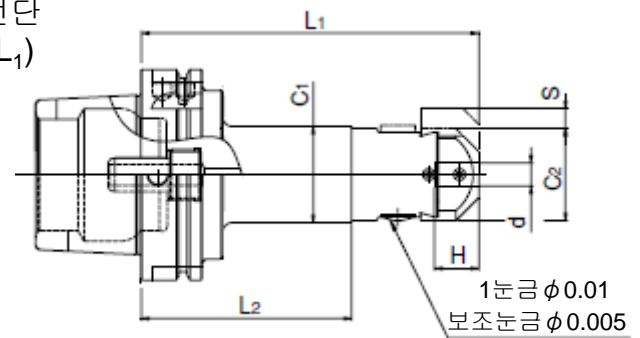
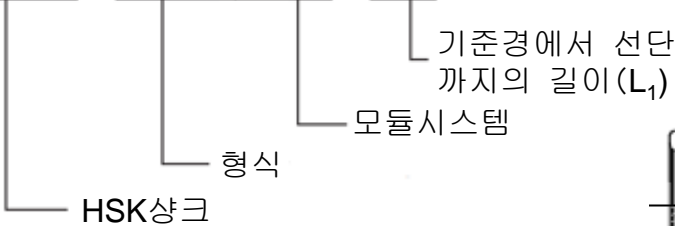


- 종래 일체형이던 보링툴을 홀더부와 상크부로 분리 표준 모듈화

### HSK 상크

#### 표시방법

HSK A63 - SBHJ03MSC - 171



품번 296	셋트형식번호	가공범위 D*	L1 (mm)	L2 (mm)	C1 (mm)	C2 (mm)	d (mm)	H (mm)	S (mm)	질량 (kg)
758568	HSK A63-SBHJ03MSC-171	3~36	171	105	50	48	12	23	10	2.9
758569	HSK A100-SBHJ03MSC-171		171	105						4.4

- L형 육각 스패너가 부착되어 있습니다.
- 바이트 및 칩은 부착되어있지 않습니다. 별도 구입 바랍니다.
- D\*는 톱보러바이트 사용시  $\phi 5.5 \sim \phi 32$  지그보러바이트 (+클램핑슬리브) 사용시  $\phi 3 \sim \phi 36$  입니다.

### 조합

품번 375	셋트형식번호	품번 375	상크형식번호	품번 296	헤드형식번호
992424	HSK A63-SBHJ03MSC-171	758525	HSK A63-MSC50-105	992092	MSC50-SBHJ03
992425	HSK A100-SBHJ03MSC-171	758531	HSK A100-MSC50-105		

**NEW**

모듈러 보링 시스템 (소경 · 중경용)

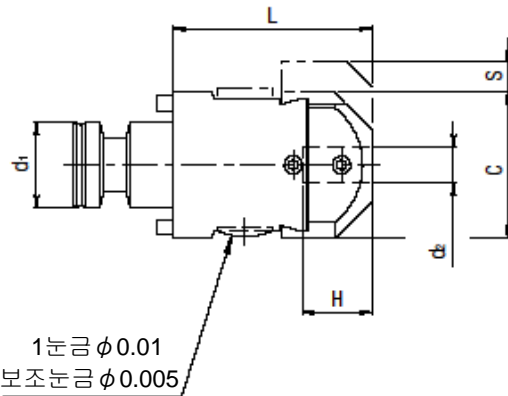
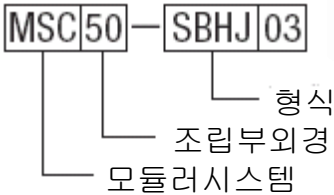
## 보링 툴 / SBHJ (소경사상가공용)

### BORING HEAD

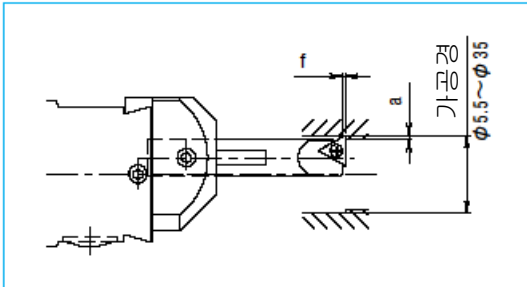


- 소경 구멍 가공용의 보링헤드로 시판중인 지그보러바이트 보링바이트가 사용 가능합니다.
- 제로클리어런스의 홈구조로 강성이 높고, 고정도의 사상가공이 가능합니다.
- 정밀나사연삭된 이송나사에 의해  $\phi 0.005\text{mm}$  미조정이 정확하게 행할 수 있습니다.

#### 표시방법



### 절삭조건



품번 296	형식번호	가공범위 D*	C (mm)	L (mm)	d1 (mm)	d2 (mm)	H (mm)	S (mm)	질량 (kg)
992092	MSC50-SBHJ03	336	48	66	28	12	23	10	0.95

- 적용바이트에  
(탕가로이 톱보러바이트 & 칩)

피삭재	절삭속도 V (m/min)	이송 f (mm/rev)	절입 a (mm)
주철	4060	0.050.10	0.10.25
강	4070	0.050.10	0.10.25
알루미늄	60100	0.050.15	0.10.5

바이트형식	칩표기호	칩재질	
		강	주물·알루
S12055-SEXPR04	EPGT040102L-W08	NS530	TH10
S1212-STUPR11	TPGT110202L-W15	NS530	TH10

- 주) ①절삭조건은 피삭재의 종류, 형상, 취부구등에 의해  
자우되며 이표를 대략으로하여 최적조건을 구하시기 바랍니다.
- ②공구상크의 과도한 돌출은 떨림발생의 원인이 되므로 돌출길이는  $L/D=5$  이내로 해주십시오.
- ③사용하는 칩의 재질에 따라서도 절삭조건을 바꾸는 것이 가능합니다.
- ④SBHJ 타입은 지그보러바이트, 보링바이트를 부착하여 사용하십시오.